

技术商务评分明细（丁伟娟）

项目名称：杭州萧山技师学院集成电路封装实训室政府采购项目（ZJHP2024-XS026（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	天津华智鑫机电技术有限公司	杭州泽迈商贸有限公司	中设（苏州）机械设备工程有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司	石家庄晟喜科技术有限公司	杭州追沐智能科技有限公司
1	商务	供应商自2021年07月01日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个合同扫描件得1.5分，最高3分。【投标文件中需提供合同扫描件并加盖投标人公章】	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2	技术	完全响应“招标技术需求”所有指标的得28分，带“■”参数负偏离每一条扣1分，其他参数负偏离每一条扣0.5分，扣完为止。	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	根据投标人提供的实施进度及供货计划。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
4	技术	根据投标人提供的详细完整的项目培训方案（包括培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数等）方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的质量保证措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0
6	技术	根据投标人提供的安全管理措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
7	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务保障能力、响应时效和故障解决方案）。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的合理化、优化建议进行评定。内容完整且与项目匹配度好的得3分；内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；内容缺失严重或与项目不匹配的得0分；不提供不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>现场演示(在评标时投标人参与现场演示, 招标代理机构仅对投标人提供电源, 其他演示所需设备由投标人自带, 总体演示时间不超过15分钟, 若投标人不提供现场演示的, 本项得分为0分。); 要求演示以下相关能力:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够在软件中展示集成电路封装前道与后道流程(1分) 2、能够展示晶圆减薄工艺参照实际仪器设备建模, 展示设备仪器结构原理(1分) 3、能够展示晶圆划片工艺中双轴晶圆切割机结构原理并通过软件可设置机器参数(1分) 4、能够展示芯片粘接工艺中用3D呈现芯片粘接设备原理(1分) 5、能够展示银浆固化工艺中操作银浆固化机, 设置固化参数, 完成银浆固化过程并展示烘焙曲线原理过程、烘焙结束后, 冷却降温过程(1分) 6、能够展示引线焊接工艺中引线焊接实际操作流程、焊接介绍、焊接过程原理动画, 展示键合头焊接实际操作过程。展示引线焊接宏观、微观原理(1分) 7、能够展示注塑工艺中注塑工艺原理过程、IC芯片结构、封装材料与围观原理动画(1分) 8、能够展示激光打标工艺中激光打字工艺过程、展示激光打字机原理说明(1分) 9、能够展示切筋成型工艺中切筋成型工艺过程、切筋成型原理说明原理、切筋、去结、去框、成型原理(1分) 10、能够展示电镀工艺中按照实际工厂流程操作电镀退火设备, 完成电镀退火过程(1分) 11、能够基于虚拟仿真自行添加选择、判断、多选题(不能添加题目或者内嵌固定题目不得分。)(1分) <p>注: 以上演示条款若不满足不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
合计			0-70	52.0	45.0	51.0	44.0	44.0	64.0

专家(签名):

技术商务评分明细（蒋毅萍）

项目名称：杭州萧山技师学院集成电路封装实训室政府采购项目（ZJHP2024-XS026（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	天津华智鑫机电技术有限公司	杭州泽迈商贸有限公司	中设（苏州）机械设备工程有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司	石家庄晟喜科技术有限公司	杭州追沐智能科技有限公司
1	商务	供应商自2021年07月01日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个合同扫描件得1.5分，最高3分。【投标文件中需提供合同扫描件并加盖投标人公章】	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2	技术	完全响应“招标技术需求”所有指标的得28分，带“■”参数负偏离每一条扣1分，其他参数负偏离每一条扣0.5分，扣完为止。	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	根据投标人提供的实施进度及供货计划。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
4	技术	根据投标人提供的详细完整的项目培训方案（包括培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数等）方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的质量保证措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0
6	技术	根据投标人提供的安全管理措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0
7	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务保障能力、响应时效和故障解决方案）。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的合理化、优化建议进行评定。内容完整且与项目匹配度好的得3分；内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；内容缺失严重或与项目不匹配的得0分；不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>现场演示(在评标时投标人参与现场演示, 招标代理机构仅对投标人提供电源, 其他演示所需设备由投标人自带, 总体演示时间不超过15分钟, 若投标人不提供现场演示的, 本项得分为0分。); 要求演示以下相关能力:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够在软件中展示集成电路封装前道与后道流程(1分) 2、能够展示晶圆减薄工艺参照实际仪器设备建模, 展示设备仪器结构原理(1分) 3、能够展示晶圆划片工艺中双轴晶圆切割机结构原理并通过软件可设置机器参数(1分) 4、能够展示芯片粘接工艺中用3D呈现芯片粘接设备原理(1分) 5、能够展示银浆固化工艺中操作银浆固化机, 设置固化参数, 完成银浆固化过程并展示烘焙曲线原理过程、烘焙结束后, 冷却降温过程(1分) 6、能够展示引线焊接工艺中引线焊接实际操作流程、焊接介绍、焊接过程原理动画, 展示键合头焊接实际操作过程。展示引线焊接宏观、微观原理(1分) 7、能够展示注塑工艺中注塑工艺原理过程、IC芯片结构、封装材料与围观原理动画(1分) 8、能够展示激光打标工艺中激光打字工艺过程、展示激光打字机原理说明(1分) 9、能够展示切筋成型工艺中切筋成型工艺过程、切筋成型原理说明原理、切筋、去结、去框、成型原理(1分) 10、能够展示电镀工艺中按照实际工厂流程操作电镀退火设备, 完成电镀退火过程(1分) 11、能够基于虚拟仿真自行添加选择、判断、多选题(不能添加题目或者内嵌固定题目不得分。)(1分) <p>注: 以上演示条款若不满足不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
合计			0-70	49.0	44.0	50.0	43.0	42.0	65.0

专家(签名):

技术商务评分明细（程远）

项目名称：杭州萧山技师学院集成电路封装实训室政府采购项目（ZJHP2024-XS026（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	天津华智鑫机电技术有限公司	杭州泽迈商贸有限公司	中设（苏州）机械设备工程有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司	石家庄晟喜科技术有限公司	杭州追沐智能科技有限公司
1	商务	供应商自2021年07月01日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个合同扫描件得1.5分，最高3分。【投标文件中需提供合同扫描件并加盖投标人公章】	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2	技术	完全响应“招标技术需求”所有指标的得28分，带“■”参数负偏离每一条扣1分，其他参数负偏离每一条扣0.5分，扣完为止。	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	根据投标人提供的实施进度及供货计划。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
4	技术	根据投标人提供的详细完整的项目培训方案（包括培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数等）方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的质量保证措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0	4.0
6	技术	根据投标人提供的安全管理措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
7	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务保障能力、响应时效和故障解决方案）。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的合理化、优化建议进行评定。内容完整且与项目匹配度好的得3分；内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；内容缺失严重或与项目不匹配的得0分；不提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>现场演示(在评标时投标人参与现场演示, 招标代理机构仅对投标人提供电源, 其他演示所需设备由投标人自带, 总体演示时间不超过15分钟, 若投标人不提供现场演示的, 本项得分为0分。); 要求演示以下相关能力:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够在软件中展示集成电路封装前道与后道流程(1分) 2、能够展示晶圆减薄工艺参照实际仪器设备建模, 展示设备仪器结构原理(1分) 3、能够展示晶圆划片工艺中双轴晶圆切割机结构原理并通过软件可设置机器参数(1分) 4、能够展示芯片粘接工艺中用3D呈现芯片粘接设备原理(1分) 5、能够展示银浆固化工艺中操作银浆固化机, 设置固化参数, 完成银浆固化过程并展示烘焙曲线原理过程、烘焙结束后, 冷却降温过程(1分) 6、能够展示引线焊接工艺中引线焊接实际操作流程、焊接介绍、焊接过程原理动画, 展示键合头焊接实际操作过程。展示引线焊接宏观、微观原理(1分) 7、能够展示注塑工艺中注塑工艺原理过程、IC芯片结构、封装材料与围观原理动画(1分) 8、能够展示激光打标工艺中激光打字工艺过程、展示激光打字机原理说明(1分) 9、能够展示切筋成型工艺中切筋成型工艺过程、切筋成型原理说明原理、切筋、去结、去框、成型原理(1分) 10、能够展示电镀工艺中按照实际工厂流程操作电镀退火设备, 完成电镀退火过程(1分) 11、能够基于虚拟仿真自行添加选择、判断、多选题(不能添加题目或者内嵌固定题目不得分。)(1分) <p>注: 以上演示条款若不满足不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
合计			0-70	49.0	42.0	45.0	40.0	42.0	63.0

专家(签名):

技术商务评分明细（李海洋）

项目名称：杭州萧山技师学院集成电路封装实训室政府采购项目（ZJHP2024-XS026（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	天津华智鑫机电技术有限公司	杭州泽迈商贸有限公司	中设（苏州）机械设备工程有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司	石家庄晟喜科技术有限公司	杭州追沐智能科技有限公司
1	商务	供应商自2021年07月01日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个合同扫描件得1.5分，最高3分。【投标文件中需提供合同扫描件并加盖投标人公章】	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2	技术	完全响应“招标技术需求”所有指标的得28分，带“■”参数负偏离每一条扣1分，其他参数负偏离每一条扣0.5分，扣完为止。	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	根据投标人提供的实施进度及供货计划。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	2.0	2.0	5.0
4	技术	根据投标人提供的详细完整的项目培训方案（包括培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数等）方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的质量保证措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
6	技术	根据投标人提供的安全管理措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0
7	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务保障能力、响应时效和故障解决方案）。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	5.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的合理化、优化建议进行评定。内容完整且与项目匹配度好的得3分；内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；内容缺失严重或与项目不匹配的得0分；不提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>现场演示(在评标时投标人参与现场演示, 招标代理机构仅对投标人提供电源, 其他演示所需设备由投标人自带, 总体演示时间不超过15分钟, 若投标人不提供现场演示的, 本项得分为0分。); 要求演示以下相关能力:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够在软件中展示集成电路封装前道与后道流程(1分) 2、能够展示晶圆减薄工艺参照实际仪器设备建模, 展示设备仪器结构原理(1分) 3、能够展示晶圆划片工艺中双轴晶圆切割机结构原理并通过软件可设置机器参数(1分) 4、能够展示芯片粘接工艺中用3D呈现芯片粘接设备原理(1分) 5、能够展示银浆固化工艺中操作银浆固化机, 设置固化参数, 完成银浆固化过程并展示烘焙曲线原理过程、烘焙结束后, 冷却降温过程(1分) 6、能够展示引线焊接工艺中引线焊接实际操作流程、焊接介绍、焊接过程原理动画, 展示键合头焊接实际操作过程。展示引线焊接宏观、微观原理(1分) 7、能够展示注塑工艺中注塑工艺原理过程、IC芯片结构、封装材料与围观原理动画(1分) 8、能够展示激光打标工艺中激光打字工艺过程、展示激光打字机原理说明(1分) 9、能够展示切筋成型工艺中切筋成型工艺过程、切筋成型原理说明原理、切筋、去结、去框、成型原理(1分) 10、能够展示电镀工艺中按照实际工厂流程操作电镀退火设备, 完成电镀退火过程(1分) 11、能够基于虚拟仿真自行添加选择、判断、多选题(不能添加题目或者内嵌固定题目不得分。)(1分) <p>注: 以上演示条款若不满足不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
合计			0-70	55.0	47.0	53.0	40.0	41.0	66.0

专家(签名):

技术商务评分明细（张寅锋）

项目名称：杭州萧山技师学院集成电路封装实训室政府采购项目（ZJHP2024-XS026（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	天津华智鑫机电技术有限公司	杭州泽迈商贸有限公司	中设（苏州）机械设备工程有限公司	成都锦蓉信息技术有限公司	石家庄晟喜科技术有限公司	杭州追沐智能科技有限公司
1	商务	供应商自2021年07月01日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个合同扫描件得1.5分，最高3分。【投标文件中需提供合同扫描件并加盖投标人公章】	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
2	技术	完全响应“招标技术需求”所有指标的得28分，带“■”参数负偏离每一条扣1分，其他参数负偏离每一条扣0.5分，扣完为止。	0-28	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3	技术	根据投标人提供的实施进度及供货计划。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0
4	技术	根据投标人提供的详细完整的项目培训方案（包括培训计划、培训课程、授课人员、培训对象与人数等）方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	2.0	1.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的质量保证措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标人提供的安全管理措施。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	4.0
7	技术	根据投标人提供的售后服务方案（包括售后服务保障能力、响应时效和故障解决方案）。方案可实施性强与项目匹配度好的得5分；方案内容较为完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	1.0	3.0	5.0
8	技术	根据投标人针对本项目提出的合理化、优化建议进行评定。内容完整且与项目匹配度好的得3分；内容基本完整且与项目匹配度较好的得2分；内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；内容缺失严重或与项目不匹配的得0分；不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>现场演示(在评标时投标人参与现场演示, 招标代理机构仅对投标人提供电源, 其他演示所需设备由投标人自带, 总体演示时间不超过15分钟, 若投标人不提供现场演示的, 本项得分为0分。); 要求演示以下相关能力:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够在软件中展示集成电路封装前道与后道流程(1分) 2、能够展示晶圆减薄工艺参照实际仪器设备建模, 展示设备仪器结构原理(1分) 3、能够展示晶圆划片工艺中双轴晶圆切割机结构原理并通过软件可设置机器参数(1分) 4、能够展示芯片粘接工艺中用3D呈现芯片粘接设备原理(1分) 5、能够展示银浆固化工艺中操作银浆固化机, 设置固化参数, 完成银浆固化过程并展示烘焙曲线原理过程、烘焙结束后, 冷却降温过程(1分) 6、能够展示引线焊接工艺中引线焊接实际操作流程、焊接介绍、焊接过程原理动画, 展示键合头焊接实际操作过程。展示引线焊接宏观、微观原理(1分) 7、能够展示注塑工艺中注塑工艺原理过程、IC芯片结构、封装材料与围观原理动画(1分) 8、能够展示激光打标工艺中激光打字工艺过程、展示激光打字机原理说明(1分) 9、能够展示切筋成型工艺中切筋成型工艺过程、切筋成型原理说明原理、切筋、去结、去框、成型原理(1分) 10、能够展示电镀工艺中按照实际工厂流程操作电镀退火设备, 完成电镀退火过程(1分) 11、能够基于虚拟仿真自行添加选择、判断、多选题(不能添加题目或者内嵌固定题目不得分。)(1分) <p>注: 以上演示条款若不满足不得分。</p>	0-11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
合计			0-70	50.0	45.0	50.0	37.0	41.0	65.0

专家(签名):